산업통상자원부 | 보도자료

보도시점 2024. 10. 30.(수) 11:00 < 10. 31.(목) 조간 > 배포 2024. 10. 30.(수)

소부장 초격차로 공급망 강국 다진다

- 「2024 소재부품장비·뿌리기술대전」개최, 첨단 소부장·뿌리산업 통합 전시
- "수출 붐업코리아 Week" 연계, 바이어 매칭 수출 상담회
- 은탑산업훈장 등 73점의 정부 포상 수여

산업통상자원부(장관 안덕근)는 10.30(수)~11.1(금) 일산 킨텍스 제1전시장에서 「2024 소재부품장비·뿌리기술대전(이하 소부장·뿌리기술대전)」을 개최한다.

올해 14번째를 맞이하는 「소부장·뿌리기술대전」은 우수 소부장·뿌리 기술·제품 통합 전시회로 소부장기업 전시관, 소부장 디지털관, 뿌리산업 정보관 등 7개의 주제(테마)관을 통해 우리 소부장·뿌리산업의 현재와 미래를 살펴볼 수 있다.

또한 역대 최대 수출 달성을 위해 "수출 붐업코리아 Week"와 연계한 글로벌 매칭 소부장 수출 상담회, 첨단 소부장 기술을 조망할 수 있는 소부장 기술 포럼 등 부대행사도 함께 열린다.

개막식(10.30, 13:30)에서는 소부장·뿌리산업 발전에 기여한 유공자에 대한 정부 포상(73점)을 수여한다. 반도체 핵심 장비인 저압화학기상증착장비(LPCVD) 등을 개발한 유진테크 현준진 부사장에 은탑산업훈장을, 디스플레이용 포토마스크 국산화에 성공한 엘지이노텍 박재석 사업담당에 철탑산업훈장을, 동아정밀공업 등 8개사에 우수 뿌리기업 선정증을 수상한다.

이승렬 산업정책실장은 "소부장이 강한 나라가 공급망 강국"이라고 강조하고 "정부는 소부장 초격차 확보를 위해 기술개발과 인력, 금융 등 현장수요 맞춤형 패키지 지원을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

담당 부서	산업공급망정책관 산업공급망정책과 뿌리산업팀	책임자	과 장	김종주 (044-203-4910)
		담당자	사무관	지 영 (044-203-4917)
		책임자	팀 장	김봉석 (044-203-4905)
		담당자	주무관	정서란 (044-203-4907)

대한민국 정책브리핑

더 아픈 환자에게 양보해 주셔서 감사합니다
가벼운 증상은 동네 병·의원으로

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

참고1 「소부장 · 뿌리기술대전」 개요

□ 목 적

○ 소부장·뿌리산업 첨단기술 성과와 미래비전 공유, 수출·투자 등 비즈니스 협력, 기업 지원의 장 마련

□ 일 정 : 2024.10.30(수) ~ 11.1(금), 킨텍스 제1전시장 1홀

□ 주요 프로그램

분야	주요 프로그램	
전시장	1 **특화단지관** • 민간 주도 첨단·소부장 기술 전시	5 **으뜸기업 홍보관** • 으뜸기업 제도 소개, 성과 등 전시
	2 **융합혁신지원관** • 소부장 지원 사업의 全단계 소개 및 상담	6 **뿌리산업 정보관** • 뿌리산업 우수모델 전시, 지원사업 소개
	3 **소부장 디지털관(AX관)** • 디지털 기술 적용 우수사례 전시	7 **소부장기업 전시관** • 반도체, 디스플레이, 이차전지 제품 홍보
	4 **유공자관** • 정부포상 유공자 특별 전시 공간 조성	
비즈니스 상담관	1 **소부장분야 수출 컨설팅·상담관** • 바이어 매칭 및 상담 통한 GVC 진입 지원	2 **국내 투자상담관** • 민간투자 유치 지원·상담
포럼 / 세미나	1 **첨단전략산업 소부장 기술포럼** • 첨단산업 분야 기술 이슈 공유	3 **뿌리산업 세미나** • 뿌리산업 분야별 주요 산업·기술 동향과 이슈
	2 **연구개발비 집행정산관리 설명회** • 연구개발비 설명, 애로 청취·해소	

□ 개막식 : 10.30(수), 13:30

○ 축사(산업부 산업정책실장), 유공자 포상(73점) 등

참고2 **소부장 · 뿌리산업 발전 유공자 주요 명단**

구분			소속	이름	직책	공적 사항
소재부품장비산업(15)	산업훈장(은탑)	1	㈜유진테크	현준진	부사장	반도체 핵심 장비인 LPCVD와 ALD 장비 개발 및 양산
	산업훈장(철탑)	2	엘지이노텍㈜	박재석	사업담당	디스플레이용 포토마스크 및 파인메탈 마스크 국산화
	산업훈장(석탑)	3	㈜동진쎄미켐	김정우	부장	V-NAND 구조 전환에 필요한 핵심 포토레지스트 개발 및 국산화
	산업포장	4	에스케이하이닉스㈜	김용탑	팀장	반도체 공정 필수 장비 및 부품의 단기 국산화
		5	삼성디스플레이㈜	이재형	부사장	중형 IT 생산성 향상을 통한 OLED 산업 외연 확장 및 소재 국산화
	대통령 표창	6	제너셈㈜	한복우	대표이사	SK하이닉스 무인 자동화 장비 개발 등 반도체 후공정 장비 경쟁력 강화
		7	㈜디에스테크노	단체	-	차세대 신소재인 CVD SiC 개발로 부품 원소재 국산화
		8	한국산업기술진흥원	단체	-	소부장 산업 경쟁력 강화 및 공급망 안정을 위한 기반 조성 및 기술사업화
		9	㈜에어레인	단체	-	에너지 절감형 고투과선택성 중공사 모듈 개발로 기체분리막 공정 국산화
		10	삼화전기㈜	윤장용	이사	세계 최초, 최고의 반도체 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)용 신제품 S-CAP 개발 및 국산화
	국무총리 표창	11	엘지이노텍㈜	장우상	전문위원	반도체용 기판 신공법 세계최초 개발 및 광학 고정밀 장비 국산화
		12	㈜세메스	최진호	수석	전량 수입하던 ArF-i 설비를 일본 기업보다 향상된 수준으로 국내 최초 개발
		13	㈜워터핀	박용석	대표이사	선박평형수 총잔류산화제 측정 장치의 독자적 기술개발 및 국산화
		14	㈜이수페타시스	단체	-	초고다층 PCB 기술 개발을 통한 해외 시장 개척 및 지방 투자 활성화
		15	㈜코밸	최영환	대표이사	LNG 선박용 초저온 Valve 개발을 통한 LNG 선박 부품 국산화
뿌리산업(3)	대통령 표창	16	동아정밀공업	단체	-	일본, 유럽에서 전량 수입에 의존하던 PET 용기 생산용 금형을 최초로 국산화
	국무총리 표창	17	㈜삼성텍	이태길	연구소장	국내 최초 전기차용 알루미늄 판재부품 Burr 융착 방지 친환경 급속냉각 기술개발
		18	㈜백조씽크	단체	-	NET신기술을 획득한 고니클리어코팅과 스크래치 저항 엠보패턴 씽크볼 기술개발

참고3 **2024년 선정된 우수 뿌리기업 목록**

□ 뿌리기업 명가 선정기업 (3개社)

기업명	대표자	업종	주요 생산품
동아정밀공업㈜	김홍렬, 김두연	금형	블로우 금형, PET 용기
㈜백조씽크	이종욱	소성가공	주방기구(씽크볼, 수전)
㈜우성염직	구홍림	표면처리	섬유 원단 염색, 가공

* 대를 잇는 전통 확산을 위해 20년 이상 경영, 가업 승계기업

□ 일하기 좋은 뿌리기업 선정기업 (5개社)

기업명	대표자	업종	주요 생산품
디에이치오토리드	이석근	주조	스티어링휠
㈜진흥주물	이상덕	주조	엔진부품, 브레이크부품, 조향장치
㈜케이피에프	송무현, 김형노	소성가공	볼트, 너트, 베어링
신성에스티㈜	안병두	소성가공	busbar, s-frame 등 자동차 부품
㈜웰템	김준기	용접	에어컨, 제습기, 공기청정기, 난로

* 근무·복지환경, 경영 안정성, 성장역량 등이 우수한 뿌리기업

참고4 **첨단전략산업 소부장 기술포럼**

□ 개요/목적

○ (목적) 반도체 첨단산업 분야의 소부장 경쟁력 제고를 위한 주요 기술동향 공유 및 산업계 확산 제고

○ 일시 및 장소 :'24. 10. 31(목) / 소부장뿌리기술대전 행사장 內

○ 내용 : 첨단 반도체 분야 소부장 핵심 기술 동향 및 이슈

□ 세부내용

○ 산학연 전문가 참여 반도체 소부장 분야 핵심 기술 전략 발표

[첨단전략산업 소부장 기술포럼 프로그램 구성]

시간	포럼내용(안)	비고
10월 31(목) 13:30~16:30 (메인무대)		
13:20-13:50 (30)	ㅇ AI 반도체의 현재와 미래	유회준 교수 (KAIST AI 반도체대학원장)
13:50-14:20 (30')	ㅇ AI반도체 성능경쟁과 핵심기술	백준호 대표 (퓨리오사)
14:20-14:50 (30')	ㅇ AFM Technology for Semiconductor Metrology and Inspection	안병운 시스템연구소장 (파크시스템즈)
14:50-15:00 (10')	ㅇ Break Time	
15:00-15:30 (30')	ㅇ AI 시대, 차세대 반도체 장비 기술 변화와 전망	안태혁 사장 (원익IPS)
15:30-16:00 (30')	ㅇ Global Semiconductor Package Business and Technology Projection	고용남 연구소장 (하나마이크론)
16:00-16:30 (30')	ㅇ AI 시대에서의 반도체 기술개발과 소부장 협력	김현우 부사장 (삼성전자)